

## ■特点 Features

采用激光焊接工艺  
 标准的 3.2 x 2.5mm陶瓷封装表面贴装形式，低成本  
 小公差及高稳定性  
 适应自动装配的8MM宽度的编带包装  
 包装：每卷1000/2000/3000/15000PCS  
 Laser welding  
 Typical 3.2 x 2.5mm Ceramic SMD package, and low cost  
 Tight tolerance and Stability  
 8mm width Tape&Reel package for automatic assembly  
 Packing: Tape & Reel, 1000/2000/3000/15000 pcs per Reel



## ■标准规格 Electronic Specification

型号 Type	SMD3225
频率范围 Frequency Range	8,000 ~ 54,000MHz
振荡模式 Oscillator Mode	Fundamental(AT cut) 基频(AT切)
调整频差 Frequency Tolerance(at25°C)	± 10ppm, ± 20ppm, ± 30ppm
温度频差 Frequency Stability	具体见表2
工作温度 Operating Temperature Range	-40°C ~ 125°C
贮存温度 Storage Temperature Range	-55°C ~ 125°C
负载电容 Load Capacitance	Custom design(8 ~ ∞ pF)
激励电平 Drive Level	100 μW Typical (300 μW max.)
静态电容 Shunt Capacitance	5pF max.
老化率 Aging	ΔFF: ± 3PPM/year(max.)

特殊技术要求可定制

## ■等效电阻 Equivalent Series Resistance(E.S.R.)

频率范围 Frequency Range	盒型 Hold Type	振荡模式 Mode	等效电阻 E.S.R.	频率范围 Frequency Range	盒型 Hold Type	振荡模式 Mode	等效电阻 E.S.R.
8,000 ~ 9,839MHz	SMD	AT,Fund	500Ω Max.	16,000 ~ 18,999MHz	SMD	AT,Fund	60Ω Max.
9,840 ~ 11,999MHz	SMD	AT,Fund	300Ω Max.	19,000 ~ 29,999MHz	SMD	AT,Fund	40Ω Max.
12,000 ~ 15,999MHz	SMD	AT,Fund	80Ω Max.	30,000 ~ 54,000MHz	SMD	AT,Fund	30Ω Max.

Table 1

## ■温度频差和工作温度范围 Frequency Stability Vs Operating Temperature range

Temp.(°C)\ppm	± 5	± 10	± 15	± 20	± 25	± 30	± 50
-10 to 60°C	△	○	○	○	○	○	○
-20 to 70°C	△	○	○	○	○	○	○
-40 to 85°C			△	○	○	○	○
-40 to 125°C						△	○

○:可实现的 △:与供应商沟通

Table 2

## ■外型尺寸 Outline Dimensions(Unit:mm)

